JP02001144339A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2001144339 A

TITLE:

LAMINATED PIEZOELECTRIC ACTUATOR AND MANUFACTURING

METHOD THEREFOR

PUBN-DATE:

May 25, 2001

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY N/A N/A

ESASHI, MASAKI SUZUKI, MANABU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME ESASHI MASAKI SUZUKI MANABU

COUNTRY N/A N/A

APPL-NO:

JP11319766

APPL-DATE:

November 10, 1999

INT-CL (IPC): H01L041/083, B81C001/00 , H01L041/187 , H01L041/22

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide laminated piezoelectric actuators, which are easily formed into a one-dimensional actuator array of an integral structure and each optimal in characteristics, and a method of manufacturing the same.

SOLUTION: Narrow and deep grooves are provided on the surface of a piezoelectric ceramic board 1 by dicing, the grooves are filled with metal 9 to serve as outer and inner electrodes respectively, and joints between the inner electrodes and outer electrodes are locally cut off by laser-aided etching, by which a structure that functions as a laminated piezoelectric actuator can be obtained.

COPYRIGHT: (C) 2001, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-144339 (P2001-144339A)

(43)公開日 平成13年5月25日(2001.5.25)

(51) Int.Cl.'		酸別記号	F I			テーマコード(参考)		
H01L	41/083		B81C	1/00				
B81C	1/00		H01L	41/08	1 0 1 D			
H01L	41/187			41/18				
	41/22			41/22				
			審査請求	京 未請求	請求項の数18	OL	(全 8 頁)	
(21)出願番号		特顯平11-319766	(71)出顧人	0001679	000167989			
				江刺	正喜			
(22)出顧日		平成11年11月10日(1999.11.10)		宮城県仙台市太白区八木山南1丁目11番地				
				9	•			
			(71)出頭人	5991587	775			
				鈴木	学			
•				宮城県	仙台市太白区向	山1-8	3-23 海藤	
				アパー	ኑ 1			
			(72)発明者	f 江刺 i	正喜			
				宫城県	山台市太白区八	木山南-	-丁目11-9	
			(74)代理人					
				弁理士	平山 一幸	(\$\)14	3)	
				•				

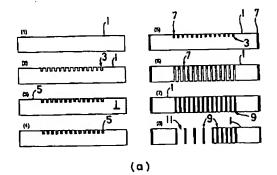
最終頁に続く

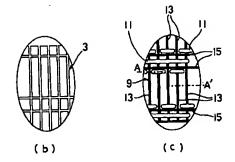
(54) 【発明の名称】 積層型圧電アクチュエータ及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 一次元アクチュエータアレイを容易に一体製作できるとともに最適な特性を持つ積層型圧電アクチュエータ及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 圧電セラミクス基板1上にダイシング加工で形成した狭くて深い溝内部に、ニッケルの電解メッキにより外部及び内部電極となる金属9を充填し、レーザー支援エッチングにより内部電極と外部電極の接続部を局所的に切断することで、積層型圧電アクチュエータとして動作する構造を製造する。





2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一方の外部電極に立設した内部電極と、他方の外部電極に立設した内部電極とを相互に対向して設け、これら一以上の両内部電極間に圧電体を固定して挟み込んだ構造を備える、積層型圧電アクチュエータ。

【請求項2】 前記外部電極と前記圧電体との間に間隙 を有していることを特徴とする、請求項1に記載の積層 型圧電アクチュエータ。

【請求項3】 前記外部電極及び前記内部電極を電解メッキで形成したことを特徴とする、請求項1又は2記載 10 の積層型圧電アクチュエータ。

【請求項4】 前記外部電極の他方の端部を共通の圧電体基板に固定して配列した一次元アレイ構造を有することを特徴とする、請求項1~3のいずれかに記載の積層型圧電アクチュエータ。

【請求項5】 前記一次元アレイ構造を二次元に配列して二次元アレイ構造アクチュエータとしたことを特徴とする、請求項4に記載の積層型圧電アクチュエータ。

【請求項6】 前記一次元アレイ構造のアクチュエータ で電気配線のスイッチングアレイを形成したことを特徴 20 とする、請求項4に記載の積層型圧電アクチュエータ。

こ9 る、請求項4に記載の積層空圧電ノクテュエータ。 【請求項7】 前記二次元アレイ構造アクチュエータを アクチュエータ単体及び複数のアクチュエータからなる ドットのいずれかを単位として触覚ディスプレイを形成 したことを特徴とする請求項5に記載の積層型圧電アク チュエータ。

【請求項8】 前記圧電体を圧電体基板をダイシングして形成したことを特徴とする、請求項1に記載の積層型圧電アクチュエータ。

【請求項9】 前記圧電体がPZT系材料であることを 特徴とする、請求項1又は8記載の積層型圧電アクチュ エータ。

【請求項10】 圧電セラミクス基板に溝を形成する第 1工程と、この溝に金属を充填する第2工程と、上記圧 電セラミクス基板の溝に対応して圧電セラミクス基板裏 面に溝を形成する第3工程と、この溝に金属を充填して 上記充填した金属と一体として内部電極及び外部電極を 形成する第3工程と、この形成した内部電極及び外部電 極をレーザー支援エッチングにより切断する第4工程 と、を備える積層型圧電アクチュエータの製造方法。 【請求項11】 前記第1工程にあって溝形成後、この

【請求項11】 前記第1工程にあって溝形成後、この 溝内部に導電性の薄膜を堆積することを特徴とする、請 求項10に記載の積層型圧電アクチュエータの製造方 法。

【請求項12】 前記導電性の薄膜を電極として電解メッキにより金属を充填することを特徴とする、請求項11に記載の積層型圧電アクチュエータの製造方法。

【請求項13】 前記第3工程にあって前記金属が露出するまで溝を加工することを特徴とする請求項10に記載の積層型圧電アクチュエータの製造方法。

【請求項14】 前記金属を電解メッキして充填したことを特徴とする、請求項10に記載の積層型圧電アクチュエータの製造方法。

【請求項15】 前記第4工程にあって、前記レーザー支援エッチングにより前記内部電極を前記外部電極に対して交互に切断するとともに素子間分離をすることを特徴とする請求項10に記載の積層型圧電アクチュエータの製造方法。

【請求項16】 前記溝が格子状であることを特徴とす) る、請求項10に記載の積層型圧電アクチュエータの製 造方法。

【請求項17】 前記溝をダイシング・ソーにより加工 することを特徴とする、請求項10又は16に記載の積 層型圧電アクチュエータの製造方法。

【請求項18】 前記レーザー支援エッチングにあって、反応性雰囲気として前記充填する金属のエッチャントを使用したことを特徴とする、請求項10に記載の積層型圧電アクチュエータの製造方法。

【発明の詳細な説明】

20 [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、一次元アクチュ エータアレイを一体製作するのに最適な積層型圧電アク チュエータ及びその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】通常、従来の積層型圧電アクチュエータは、圧電セラミクス粉末、バインダ及び溶媒などを混合して泥状にしたスラリーをキャスティング成膜したグリーンシート上に、内部電極となる銀ペーストを印刷したものを積層圧着し焼結することによって製造される。この積層型圧電アクチュエータは100μm程度の厚さの圧電セラミクス層を100層程度積層したものが一般的であり、100Vの駆動電圧で10μm程度の変位が得られる。この製造方法は、積層セラミクスコンデンサの製造方法を応用したものであり、大量かつ廉価に製造できるという特徴を有している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 積層型圧電アクチュエータ製造方法では、特性の良好な 積層体を得るために高い圧力をかけながら高温で焼結さ せる必要があり、大規模な炉等の施設が必要となる。ま た、良好な圧電特性を得るには、焼結過程における圧力 や温度などのパラメータの最適化が不可欠である。 【0004】さらに、従来の積層型圧電アクチュエータ

【0004】さらに、従来の積層型圧電アクチュエータでは、積層体側面に切断後の内部電極を露出させ、この側面の内部電極端部の一層おきにガラス絶縁物を形成し、裏面には一層ずらした位置に同様にガラス絶縁物を形成し、最後にこれらの上から外部電極を塗布、焼き付けにより形成して全ての内部電極を一層おきに電気的に並列して接続しており、このガラス絶縁物をいかに正確

50 にかつ能率良く形成するかが工業的に圧電アクチュエー

タ素子を大量生産するためのポイントになっている。 【0005】またアクチュエータアレイを製作する場合、個々のアクチュエータを何らかの手段で位置決めして並べる必要があり、作業効率が劣るという解決すべき課題がある。

【0006】そこで、この発明は、焼結済み圧電セラミクス基板を用いることにより、大規模な炉などの設備や焼結条件の最適化を必要としないで、一次元アクチュエータアレイを容易に一体製作できるとともに最適な特性を持つ積層型圧電アクチュエータ及びその製造方法を提 10供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明のうちで積層型圧電アクチュエータの請求項1記載の発明は、一方の外部電極に立設した内部電極と、他方の外部電極に立設した内部電極とを相互に対向して設け、これら一以上の両内部電極間に圧電体を固定して挟み込んだ構造を備える構成とした。請求項2記載の発明は、上記構成に加え、外部電極と圧電体との間に間隙を有していることを特徴とする。

【0008】また請求項3記載の発明は、外部電極及び内部電極を電解メッキで形成したことを特徴とするものである。さらに請求項4記載の発明は、外部電極の他方の端部を共通の圧電体基板に固定して配列した一次元アレイ構造を有することを特徴とする。また請求項5記載の発明は、一次元アレイ構造を二次元に配列して二次元アレイ構造アクチュエータとしたことを特徴とする。

【0009】さらに請求項6記載の発明は、一次元アレイ構造のアクチュエータで電気配線のスイッチングアレイを形成したことを特徴とする。また請求項7記載の発 30 明は、二次元アレイ構造アクチュエータをアクチュエータ単体及び複数のアクチュエータからなるドットのいずれかを単位として触覚ディスプレイを形成したことを特徴とするものである。さらに請求項8記載の発明は、圧電体を圧電体基板をダイシングして形成したことを特徴とする。また請求項9記載の発明は圧電体がPZT系材料であることを特徴とする。

【0010】このような構成により、本発明の積層型圧電アクチュエータは、圧電特性のばらつきがなく、圧電特性から計算される最適な変位発生力や周波数応答を得40ることができる。

【0011】また本発明のうち、積層型圧電アクチュエータの製造方法の請求項10記載の発明は、圧電セラミクス基板に溝を形成する第1工程と、溝に金属を充填する第2工程と、圧電セラミクス基板の溝に対応して圧電セラミクス基板裏面に溝を形成する第3工程と、溝に金属を充填して充填した金属と一体として内部電極及び外部電極を形成する第3工程と、形成した内部電極及び外部電極を形成する第3工程と、形成した内部電極及び外部電極をレーザー支援エッチングにより切断する第4工程と、を備える構成とした。

112001 1441

【0012】さらに請求項11記載の発明は、上記構成に加え、第1工程にあって溝形成後、溝内部に導電性の薄膜を堆積することを特徴とするものである。また請求項12記載の発明は、導電性の薄膜を電極として電解メッキにより金属を充填することを特徴とする。さらに請求項13記載の発明は、第3工程にあって、金属が露出するまで溝を加工することを特徴とする。また請求項14記載の発明は、金属を電解メッキして充填したことを特徴とする。

【0013】さらに請求項15記載の発明は、第4工程にあって、レーザー支援エッチングにより内部電極を外部電極に対して交互に切断するとともに素子間分離をすることを特徴とするものである。また請求項16記載の発明は、溝が格子状であることを特徴とする。さらに請求項17記載の発明は、溝をダイシング・ソーにより加工することを特徴とするものである。また請求項18記載の発明は、レーザー支援エッチングにあって、反応性雰囲気として充填する金属のエッチャントを使用したことを特徴とする。

20 【0014】このような構成により、この発明の積層型 圧電アクチュエータの製造方法は、大規模な炉などの設 備及び焼結条件の最適化が不要でかつ容易に一次元アレ イ構造の積層型圧電アクチュエータを製造することがで きる。

[0015]

【発明の実施の形態】この発明の積層型圧電アクチュエータは、断面が数mm×0.5mm程度で、100μm程度の幅の圧電セラミクス層を積層した物である。焼結済みの圧電セラミクス基板を用いることで、大規模な設備や焼結条件の最適化を必要としない積層型圧電アクチュエータの製造方法を実現する。この積層型圧電アクチュエータはダイシング加工で形成した狭くて深い溝の内部に、ニッケルの電解メッキにより内部電極及び外部電極となる金属を充填し、レーザー支援エッチングにより内部電極と外部電極の接続部を局所的に切断することで、積層アクチュエータとして動作する構造を得ることができる。

【0016】また、本発明は、直線状に複数個の積層型 圧電アクチュエータが規則的に配列した基板に対し、レ ーザー支援エッチングを行い、アクチュエータ各素子間 の不要部分を切断することで、積層型圧電アクチュエー タの一次元アレイ構造を一体成形することができるもの である。

【0017】以下、図面に示した好適な実施の形態の詳細を説明する。図1は本発明の積層型圧電アクチュエータ製造方法を示す図であり、(a)は製造工程図、

(b)は工程図(2)における圧電セラミクス基板の一部の上面図、(c)は工程図(8)における圧電セラミクス基板の一部上面図である。図1を参照して、本実施50 形態に係る積層型圧電アクチュエータの製造方法は、先

図である。

ず、図1(a)の工程図(1)及び(2)に示すよう に、厚さが500 µm程度の平板形状の圧電セラミクス 基板1の表面に、この表面から深さが100μm程度、 幅が30μm程度の溝を130μm程度のピッチで、図 1 (b)に示すように格子状の溝3を加工する。

【0018】この溝加工には例えばダイシング・ソーを 使用し、溝加工用のダイシング・ブレードとしては例え ば厚さ25μmの非常に薄い物を使用する。この格子状 の溝3の深さは、後述する電解メッキで溝内部に空洞が 生じないように金属を充填可能な100μm程度と浅く 10 形成するのがよい。

【0019】圧電セラミクス基板としては、チタン酸バ リウム(BaTi3)、PZT(チタン酸ジルコン酸 鉛、Pb(Tix、Zr1-x)3)及び結晶成分Pb、 Zr、Ti以外の微量成分を添加したPZT系材料等を 使用できるが、圧電特性の良好な材料がよい。なお、こ こではPZT系材料はPZTも含む。

【0020】次に、工程図(3)に示すように格子状の 溝3の溝内部を含む圧電セラミクス基板1表面上に導電 性の薄膜5をスパッターなどで堆積し、工程図(4)に 20 示すように圧電セラミクス基板1上面の堆積した薄膜を 研磨して取り除く。導電性の薄膜は膜の密着性がよくス パッタリングで形成可能な物が好ましい。例えば本実施 形態ではAu/Crを使用した。

【0021】次いで工程図(5)に示すように、導電性 の薄膜5を電極として、例えばニッケルの電解メッキを 行い、格子状の溝3内部を金属電極7、例えばニッケル で充填する。図示していないが本実施形態ではニッケル の電解メッキ浴として、内部応力が低く、高速なメッキ が可能なスルファミン酸ニッケル及び塩化ニッケルの混 30 合浴を用いた。

【0022】次に工程図(6)に示すように、圧電セラ ミクス基板1裏面から金属電極7が露出する約400μ mの深さまで第一回目のダイシング加工と位置を合わせ て、第二回目のダイシング可能を行う。このとき底部に 金属電極が露出しないと、次の電解メッキを行うことが 不可能となるので、第二回目のダイシング位置及び深さ は正確に合わせる必要がある。

【0023】そして、工程図(7)に示すように、第一 回目にメッキしたニッケルを電極として第二回目のニッ 40 ケル電解メッキを行い、格子状の溝3をニッケルで完全 に充填し、電極部9を形成する。このようにダイシング と電解メッキを二回行うことにより幅の狭い高アスペク ト比の溝に空洞を生じずに金属を充填することができ る。なお、後述するがこの電極部は積層型圧電アクチュ エータの内部電極及び外部電極になるが、本実施形態で は同時に一体的に形成可能である。

【0024】最後に、工程図(8)及び図1(c)に示 すように、レーザー支援エッチング(以下、「LAE:

ーを収束して照射し、電極部9を内部電極13と外部電 極15とが交互につながっているように局所的に切断す る。

【0025】このLAEによる局所的にエッチングする 技術は、使用するレーザーの波長や反応性雰囲気の組み 合わせによって、各種の圧電セラミクスに適用できる。 なお、工程図(8)及び図1(c)における11は切断 部を示す。また工程図(8)は図1(c)のA-A'断 面の一部を端面に示す。

【0026】図2は本実施形態に係る格子状の溝に電極 部が形成された圧電セラミクス基板の上面図であり、 (a) は図1 (a) の工程図 (8) で示した圧電セラミ クス基板の両端部に形成されていた金属電極を除去した 上面図、(b)は(a)図の一方の端部を切断した上面

【0027】図2(a)に示すように、内部電極13が 交互に外部電極 1·5 につながっているように電極部 9 を 切断し、図2(a)及び(b)に示すように、同時に積 層型圧電アクチュエータ素子20間の分離も行い、この 積層型圧電アクチュエータ素子20が一次元アレイ構造 に形成される。

【0028】したがって、本実施形態の積層型圧電アク チュエータの製造方法では、LAEによって圧電セラミ クス基板の一部をつないだまま素子間だけを分離するこ とができるので、一体型の一次元のアクチュエータ・ア レイが容易に製作できるとともに、層数の多い積層アク チュエータが製造できる。

【0029】次に本実施形態に係るLAEについて説明 する。図3は本実施形態に係るLAE装置概略図であ る。図3を参照して本実施形態に係るLAE装置30 は、パルスステージ21と、このパルスステージを駆動 するパルスモータードライバー23と、パルスステージ を制御するステージコントローラ25と、このステージ コントローラとNd: YAGレーザー29に同期制御信 号を送り制御するコンピュータ27と、反射鏡31と、 レンズ33と、PZT35を固定台36に取り付けると 共にFeC13水溶液37中に入れた容器39とを備え ている。なお、図3中の矢印は制御信号の流れを示す。 【0030】通常、PZTのLAEでは反応性雰囲気と してKOH水溶液が使用されるが、本実施形態ではPZ Tと同時にニッケルのエッチングを行う必要がある。ニ ッケルはΚΟΗ水溶液に対する耐性が高く、レーザー光 によってアシストしても容易にはエッチングされない。 そこで、KOHの代わりに、ニッケルのエッチャントの 一つであるFeC13 水溶液を使用する。

【0031】しかし、通常使用されるような30~40 w t %程度の溶液を使用すると、レーザーを照射してい ない部分までエッチングされてしまうので、2~5wt %の希薄な水溶液を使用するのが好ましい。このように と記す)により、反応性雰囲気中で試料の表面にレーザ 50 FeC 13 水溶液ではレーザー光を照射した部分が加熱 され、化学反応が促進された結果、ニッケル部分もエッチングすることができる。

【0032】次に、本実施形態に係る積層型圧電アクチュエータについて説明する。図1に示した製造工程は、一枚の圧電セラミクス基板上に複数の積層型圧電アクチュエータを形成したもので、一次元アレイ構造の積層型圧電アクチュエータが製造できる。これらを切り離してアクチュエータ単体として使用することも可能である。【0033】本発明に係る積層型圧電アクチュエータは、一方の外部電極に立設した内部電極と、他方の外部10電極に立設した内部電極とを相互に対向して設け、これら一以上の両内部電極間に圧電体を固定して挟み込んだ構造を備えるものである。

【0034】図4は本実施形態に係る積層型圧電アクチュエータ単体の外観図である。図4を参照して、積層型圧電アクチュエータ単体40は、内部電極43が交互に外部電極45,45に接続され、この内部電極43,43間に圧電セラミクス41が挟まれ、層構造をなす圧電セラミクス41が外部電極45,45に対して間隙46を有する。つまり、櫛形の電極45,45を2つ相互に噛み合わせ、内側に位置する電極43,43間に圧電セラミクス41を挟んだ構造を有する。この積層型圧電アクチュエータ単体40の外部電極45,45に電圧印加可能に電気端子48が設けられる。

【0035】圧電セラミクスのPZT層の幅L1 は10 0μ m、ニッケル内部電極43の幅L2 は3 0μ m、厚さdは5 00μ mである。特性を評価するために、

(a) 幅Wが3mm、PZT層数Nが23層、(b) 幅
 Wが2mm、PZT層数Nが60層、(c) 幅Wが2mm、PZT層数Nが120層、の同形状の積層型圧電ア 30
 クチュエータを作製した。これらの積層型圧電アクチュエータを分極した後、電圧を印加して変位を測定した。分極条件は100℃、DC200V、30分である。

【0036】図5は本実施形態に係る積層型圧電アクチュエータの変位特性図である。図5に示すように、100Vの電圧を加えたとき圧電効果により、Nが23層で2.5μm、Nが120層で7.3μmの変位が得られる。これらの値は使用した材料の圧電定数から計算される変位とほぼ一致しており、バルク材料の圧電特性がそのまま反映されている。したがって本発明に係る積層型40圧電アクチュエータでは変位発生力や周波数応答についても圧電特性から計算される特性が得られる。

【0037】従来のグリーンシートの積層体を焼結するプロセスでは、焼結時の条件の変化によって圧電特性がばらつく恐れがあるが、本実施形態では圧電セラミクスのバルク材料をダイシングするため圧電特性のばらつきが生じる恐れが無く、特性の揃った積層型圧電アクチュエータを製作することができる。

【0038】次に、本実施形態の使用方法について説明 【図6】本発明に係る触覚する。図6は本発明に係る触覚ディスプレイ用アクチュ 50 タ・アレイの外観図である。

,,2001 11

エータ・アレイの外観図である。図6に示すように、本発明に係る触覚ディスプレイ用アクチュエータ・アレイ50は、例えば配線基板53上に一次元アレイ構造積層型圧電アクチュエータ51を二次元状に配列したものであり、各積層型圧電アクチュエータ単体又はドット状を形成する複数の積層型圧電アクチュエータを触覚に対応する点ドットにして触覚ディスプレイに利用するものである。

【0039】また一次元アレイ構造の積層型圧電アクチュエータでは、電気配線のスイッチングアレイに適用可能であり、また積層型圧電アクチュエータ単体ではディスクなどのポジショナーとしても利用可能である。

【0040】なお、本発明は例示的な実施の形態について説明したが、開示した実施形態に関して、本発明の要旨及び範囲を逸脱することなく、種々の変更、省略、追加が可能であることは当業者において自明である。したがって本発明は実施の形態に限定されるものではなく、請求の範囲に記載された構成要素によって規定される範囲及びその均等範囲を包含するものとして理解されなければならない。さらに好適な実施の形態において説明する具体的な数値等は本発明の範囲を限定するものではなく、必要に応じて適宜変更可能である。

[0041]

【発明の効果】以上の説明から理解されるように、本発明の積層型圧電アクチュエータでは、圧電特性のばらつきがなく、最適な変位発生力や周波数応答を得ることができるという効果を有する。また本発明の積層型圧電アクチュエータの製造方法では、大規模な炉などの設備及び焼結条件の最適化が不要でかつ容易に一次元アレイ構造の積層型圧電アクチュエータを製造することができる

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の積層型圧電アクチュエータ製造方法を示す図であり、(a)は製造工程図、(b)は工程図(2)における圧電セラミクス基板の一部上面図、

(c)は工程図(8)における圧電セラミクス基板の一部上面図である。

【図2】本実施形態に係る格子状の溝に電極部が形成された圧電セラミクス基板の上面図であり、(a)は図1(a)の工程図(8)で示した圧電セラミクス基板の両端部に形成されていた金属電極を除去した上面図、

(b)は(a)図の一方の端部を切断した上面図である。

【図3】本実施形態に係るLAE装置の概略図である。

【図4】本実施形態に係る積層型圧電アクチュエータ単体の外観図である。

【図5】本実施形態に係る積層型圧電アクチュエータの 変位特性図である。

【図6】本発明に係る触覚ディスプレイ用アクチュエータ・アレイの外観図である。

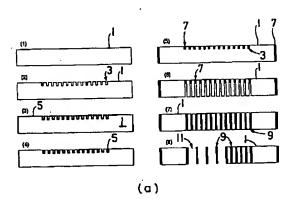
10

【符号の説明】

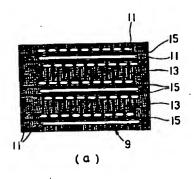
- 1 圧電セラミクス基板
- 3 格子状の溝
- 5 薄膜
- 7 金属電極
- 9 電極部
- 11 切断部
- 13,43 内部電極
- 15,45 外部電極
- 20 積層型圧電アクチュエータ素子
- 21 パルスステージ
- 23 パルスモータードライバー
- 25 ステージコントローラ
- 27 コンピュータ

- 29 レーザー
- 31 反射鏡
- 33 レンズ
- 35 PZT
- 36 固定台
- 37 FeCl3 水溶液
- 39 容器
- 40 積層型圧電アクチュエータ単体
- 41 圧電セラミクス
- 10 46 間隙
 - 48 電気端子
 - 50 触覚ディスプレイ用アクチュエータ・アレイ
 - 51 一次元アレイ構造積層型圧電アクチュエータ
 - 53 配線基板

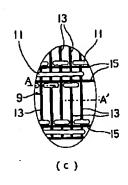
【図1】

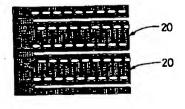


【図2】



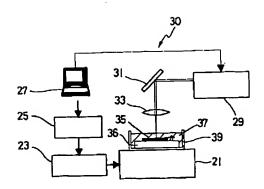


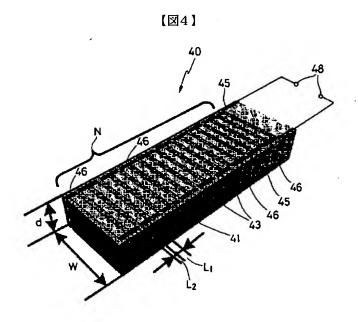


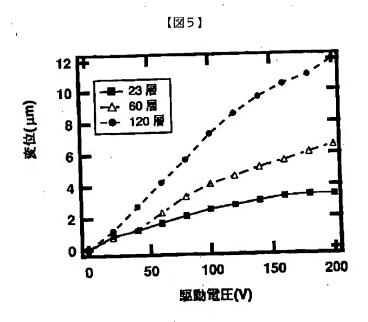


(b)

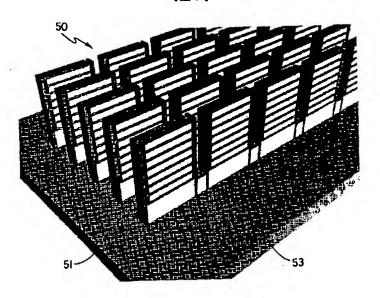
【図3】







【図6】



フロントページの続き

(72)発明者 鈴木 : 学 宮城県仙台市太白区向山1-8-23 海藤 アパート1

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.